


PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn áp dụng: Endface (Polishing và Final Endface)	Số PS: 4-OP-527-5-PS-012-0015		Ver : 3
SẢN PHẨM: MAGETSUYO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-527		

Vùng Core (0~25 µm)

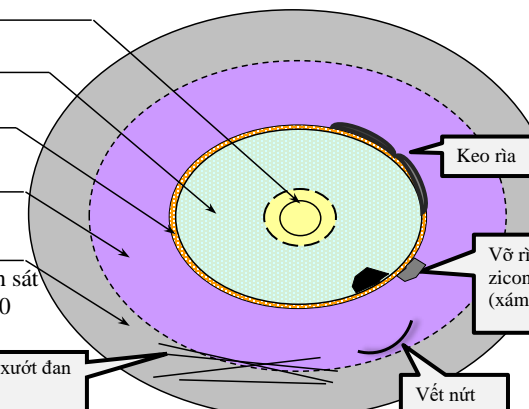
Vùng Cladding (25 ~ 120µm)

Vùng keo (120 ~ 130µm)

Vùng Ziconia A (130 µm~ 250 µm)

Vùng Ziconia B (250 µm~ vùng quan sát trên màn hình ~400 µm)

Mài không hết (vết xước đan nhau)



Điều chỉnh microscope để thấy endface **rõ nhất, giữ nguyên** rồi đánh giá.

Vết xước cùng với chip dây, đánh giá lỗi này theo chuẩn của vết xước và vết chip

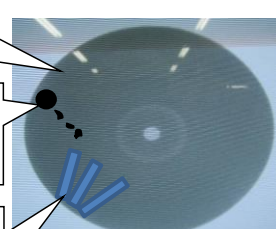
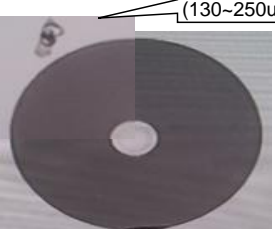
Vết bóng đen riêng rẽ đánh giá như lỗi xước.

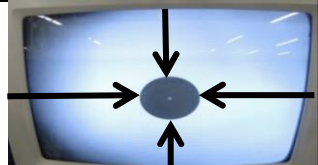
Các vết bóng đen có cùng điểm xuất phát và nhiều hơn 3 nhánh rẽ ra thì đánh giá **rốt**

Chú ý: Endface của sản phẩm Magetsuyo **có vòng tròn trắng** bao quanh core. **Nếu không thấy vòng tròn này báo cho Leader**

Chip vùng (130~250µm)


Vỡ rìa cladding (đen)




Chú ý: Chỉnh Fiber Endface của sản phẩm Magetsuyo **ngay tại giữa màn hình** để mở rộng vùng quan sát trên

Sáng



Tối



Bật sáng để kiểm vùng fiber
Bật tối kiểm vùng zirconia

***Quy định:** Trong quá trình thao tác, không được tác động đến nhãn serial (viết, làm dơ, làm nhãn,...) vì nhãn serial này sẽ được giao cho khách hàng

Chú ý: Công đoạn final endface bật cả 2 chế độ sáng và tối để kiểm tra, công đoạn polishing chỉ bật chế độ sáng để kiểm tra.

Vùng (Đường kính)	Tiêu chuẩn	Đánh giá	Độ phóng đại
Vùng Core (0~25 µm)	Vết xước rộng ≤ 3 µm và số lượng ≤ 2 vết	Ok	<h1>X400</h1>
	Vết chip rộng ≤ 3 µm và số lượng ≤ 2 vết	Ok	
	Không có bất kỳ vết nứt	Ok	
Vùng Cladding (25~120 µm)	Vết xước rộng ≤ 3 µm và không giới hạn số lượng	Ok	
	Vết chip rộng ≤ 10 µm và không giới hạn số lượng	Ok	
	Không có bất kỳ vết nứt	Ok	
Vùng Keo (120 ~130 µm)	Vỡ rìa cladding, ziconia rộng ≤ 10µm & chiều dài tổng các vết < 1/4 chu vi Cladding, Ziconia	Ok	
	Keo rìa rộng ≤ 5µm & chiều dài rìa keo < 3/4 chu vi Cladding	Ok	
Vùng Ziconia A (130 µm~250 µm)	Vết chip rộng ≤ 50 µm và không giới hạn số lượng	Ok	
	Chấp nhận bất kỳ vết nứt	OK	
	Không có lỗi mài không hết (nhiều vết xước đan xen hay gần nhau)	Ok	
Vùng Ziconia B (250 µm ~ vùng quan sát)	Yêu cầu vệ sinh sạch các vết bẩn . Vết chip rộng ≤ 50 µm và không giới hạn số lượng.	Ok	
	Không có lỗi mài không hết (nhiều vết xước đan xen hay gần nhau)	Ok	
	Chấp nhận 1 vết nứt nếu nhiều hơn cần báo cho KT sư nhóm Polishing đánh giá.	Ok	

Chú ý: Vết bẩn yêu cầu được vệ sinh sạch, vết không thể vệ sinh thì đánh giá như lỗi chip.

Đường kính vết chip đo theo biên dạng dài nhất. Thông tin cho Leader nếu thấy lỗi bất thường

Revision History				
Date	PIC	Ver	Content	Requester
23-Oct-24	Khoa	3	- Thêm quy định đối xử với nhãn serial	TanNDD
11-Nov-16	Bungnv	2	thêm ngày hiệu lực theo EIC	Tunv
4-Mar-16	Sinh LV	1	Đổi số tài liệu từ 4-OP-333-4-PS-END-0066 sang 4-OP-527-5-PS-012-0015. Công đoạn final endface bật cả 2 chế độ sáng và tối để kiểm tra, công đoạn polishing chỉ bật chế độ sáng để kiểm tra.	Maget